

证券代码：688261

证券简称：东微半导

公告编号：2024-020

苏州东微半导体股份有限公司

关于参加 2023 年度芯片设计行业集体业绩说明会暨 现金分红说明会暨 2024 年第一季度业绩说明会的公 告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 会议内容：2023 年度芯片设计行业集体业绩说明会暨现金分红说明会暨 2024 年第一季度业绩说明会
- 会议召开时间：2024 年 5 月 13 日(星期一)下午：15:00-17:00
- 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）
- 会议召开方式：线上文字互动
- 投资者可于 2024 年 5 月 10 日(星期五) 16:00 前通过邮件、电话、传真等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。

苏州东微半导体股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 4 月 27 日发布了公司 2023 年年度报告，并将于 2024 年 4 月 30 日发布公司 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度的经营成果和财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 13 日下午 15:00-17:00 参加由上海证券交易所主办的 2023 年度芯片设计行业集体业绩说明会，就投资者普遍关注的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以线上文字互动的方式召开，公司将针对 2023 年度、2024 年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间：2024 年 5 月 13 日下午：15:00-17:00

(二) 会议召开地点：(网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>)

三、参加人员

董事长、总经理龚轶先生；财务负责人谢长勇先生；董事、董事会秘书李麟女士；独立董事毕嘉露女士（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在 2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 15:00-17:00，登录上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

(二) 投资者可于 2024 年 5 月 10 日（星期五）16:00 前通过邮件、电话、传真等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：公司董事会办公室

电话：0512-62668198

邮箱：enquiry@orientalsemi.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

苏州东微半导体股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日